華 民 國 專 利 公 報 (19)(12)

(11)公告編號:34.153-4-

(44)中華民國87年(1998)10月01日

發明

全 4 頁

(51) Int · C | 5:80883/12

(54)名

初:胡园清洗及粒子去除装置

(21)申 請 案 號:86118214

(22)申請日期:中華民國86年(1997)12月03日

(72)發 阴 人: 程萬里

新竹市中華路四段四一一卷二十號

(71)申 請 人: 世界先進積體電路股份有限公司

新竹科學工業園區新竹縣園區三路一二三號

〔74〕代 理 人:蔡坤射 先生

1

[57]申請專利範圍:

1.一種晶圓清洗及粒子去除之裝置,該晶 圓清洗及粒子去除之裝置包含:

一容器,用以承裝液體,該容器具有至 少一液體注入裝置,至少一液體輸出

- 口,設置於容器之底部以及一液體排出
- 口,設置於容器之底部用以排出液體;

一音波傳導裝置,設置於該容器之上; 超音波產生裝置,連接於該音波產生 裝置用以產生超音波,以利於粒子之去 除,該音波傳導裝置用以傳導該超音 波;

一液體供給源,連接於該音波傳導裝置 以及該至少一液體注入裝置,用以供給 該液體至該容器中:

- 一驅動裝置, 連接於該至少一液體輸出口, 用以驅動該液體循環於該粒子去除 裝置之中:
- 一過濾裝置,連接於該驅動裝置,用以 過濾該液體中之雜質:
- 一第一閥門,設置於該液體供給源以及

2

該音波傳導裝置之間:及

至少一第二閥門,設置於該液體供給裝置以及該至少一液體注入裝置之間。

- 2.如申請專利範圍第1項之晶圓清洗及粒子去除裝置,其中上述之至少一液體注入裝置設置於該容器壁中,該液體藉由該至少一液體注入裝置注入該容器之中。
- 3.如申請專利範圍第1項之晶圓清洗及粒 10. 子去除裝置,其中上述之粒子去除裝置 包含一噴嘴,設置於該至少一液體注入 裝置之末端,用以噴灑該液體。
 - 4.如申請專利範圍第3項之晶圓清洗及粒子去除裝置,其中上述之至少一液體注 15. 入裝置設置於該容器壁中,該液體藉由 該至少一液體注入裝置以及該噴嘴注入 該容器之中。
 - 5.如申請專利範圍第1項之晶圓清洗及粒子去除裝置,其中上述之粒子去除裝置 包含複數個管路,設置於該容器之底

20.

5.

部,該複數個管路具有複數個開孔,用 以噴灑該液體至該容器之中。

- 6.如申請專利範圍第1項之晶圓清洗及粒子去除裝置,其中上述之液體為去離子水。
- 7.如申請專利範圍第1項之晶圓清洗及粒子去除裝置,其中上述之容器之材質為石英。
- 8.如申請專利範圍第1項之晶圓清洗及粒子去除裝置,其中上述之高音波產生裝置所產生之該超音波頻率約為900至1100kHz。
- 9.一種晶圓清洗及粒子去除裝置,該晶圓 清洗及粒子去除裝置至少包含:
 - 一容器,用以容納晶圓以及承裝液體, 該容器具有至少一液體注入裝置、至少 一液體輸出口,設置於容器之底部以及 一液體排出口,設置於容器之底部用以 排出液體;
 - 一噴嘴,設置於該至少一液體注入裝置 之末端,用以噴灑該液體:
 - 一音波傳導裝置,設置於該容器之上: 一超音波產生裝置,連接於該音波產生 裝置用以產生超音波,以利於粒子之去 除,該音波傳導裝置用以傳導該超音 波:
 - 一液體供給源,連接於該音波傳導裝置 以及該至少一液體注入裝置,用以供給 該液體至該容器中;
 - 一驅動裝置,連接於該至少一液體輸出口,用以驅動該液體循環於該粒子去除 裝置之中:
 - 一過濾裝置,連接於該驅動裝置,用以 過濾該液體中之雜質:
 - 一第一閥門,設置於該液體供給源以及 該音波傳導裝置之間:及

至少一第二閥門,設置於該液體供給源

以及該至少一液體注入裝置之間。

- 10.一種晶圓清洗及粒子去除裝置,該晶 圓清洗及粒子去除裝置至少包含:
- 一容器,用以容納晶圓以及承裝液體, 5. 該容器具有至少一液體注入裝置、至少 一液體輸出口,設置於容器之底部以及 一液體排出口,設置於容器之底部用以 排出液體;
- 一音波傳導裝置,設置於該容器之上: 10. 一超音波產生裝置,連接於該音波產生 裝置用以產生超音波,以利於粒子之去 除,該音波傳導裝置用以傳導該超音 波:
- 一液體供給源,連接於該音波傳導裝置 15. 以及該至少一液體注入裝置,用以供給 該液體至該容器中;
 - 一驅動裝置,連接於該至少一液體輸出口,用以驅動該液體循環於該粒子去除 裝置之中:及
- 一過濾裝置,連接於該驅動裝置,用以 過滤該液體中之雜質。
 - 11.如申請專利範圍第10項之晶圓清洗及 粒子去除裝置,其中上述之晶圓清洗及 粒子去除裝置至少包含一第一閥門,設 置於該液體供給源以及該音波傳導裝置 之間。
 - 12.如申請專利範圍第10項之皛圓清洗及 粒子去除裝置,其中上述之粒子去除裝 置包含一第二閥門,設置於該液體供給 裝置以及該至少一液體注入裝置之間。 圖式簡單說明:

第一圖為傳統之晶圓清洗及粒子去 除裝置。

第二圖為傳統之晶圓清洗及粒子去 35. 除裝置。

> 第三圖為本發明之晶圓清洗及粒子 去除裝置。

25.

30.





